

客户 Customer: _____

日期 DATE: _____

纳入仕様书 SPECIFICATION

产 品 名 称 PRODUCT NAME: 叠层片式低通滤波器

Multilayer Chip Low Pass Filter

贵 司 料 号 YOUR PART NO.: _____

敝 司 料 号 OUR PART NO.: MLPF0605M0915P69-L10

接受 RECEPTION THE SPECIFICATION HAS BEEN ACCEPTED. 该纳入仕様书已被我司接受 日期: DATE: 公司: COMPANY:		
批准 CFMD	审核 CHKD	接收 RCVD

本纳入仕様书共 7 页

MANUFACTURING NAME

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
 SHENZHEN MICROGATE TECHNOLOGY CO., LTD
 TEL: 86-755-28085000
 FAX: 86-755-28085605

CFMD. 批准	CHKD. 审核	DSGD. 担当
梁启新	付迎华	曾艳峰

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
 地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号
 电话(Tel): 0755-28085000 传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

纳入仕様书改定履历 MODIFY HISTORY OF SPECIFICATION

NO.	DATE	CONTENT	APPROVED
1	2014.5.15	初稿	

目录 CATALOG

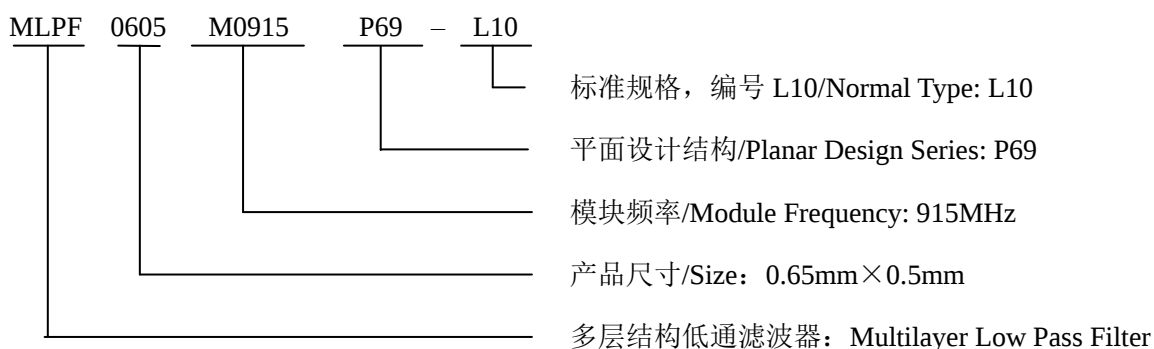
1 适用范围 Scope.....	4
2 品名构成 Product Identification.....	4
3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material.....	4
4 测试条件 Testing Conditions.....	5
5 电气性能 Electrical Characteristics.....	5
6 特性曲线 Characteristic curve.....	6
7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions.....	7

1 适用范围 Scope

“麦捷”微波低通滤波器系列产品设计用于 PHS、WLAN、GSM、Bluetooth、PDA 和无绳电话机中，具有低损耗、高衰减和小体积 SMD 片式设计，能减少复杂的调校工作，可以简化电路设计。

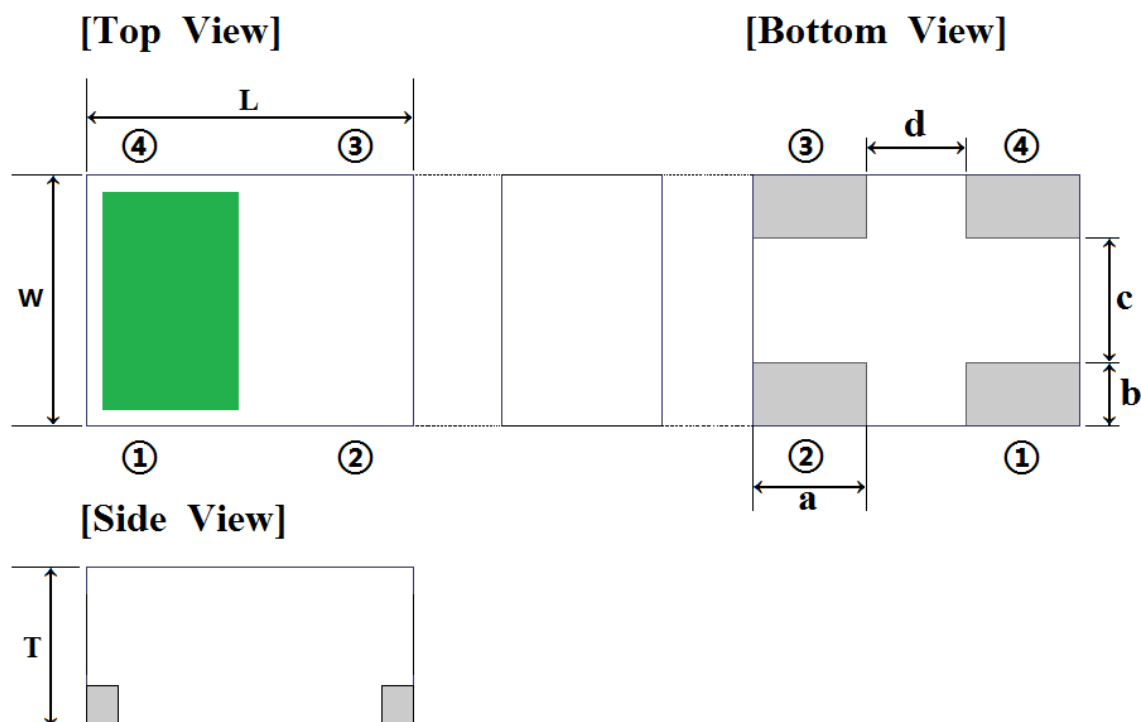
“Microgate” Microwave Low Pass Filter series are designed to be used in PHS、WLAN、GSM、Bluetooth、PDA & Cordless phones with low insertion loss and high attenuation as well as small size SMD chip design , which can simplify your complex tuning and circuit design .

2 品名构成 Product Identification



3 形状、尺寸和材料 Appearance, Dimensions and Material

a、Mechanical Dimensions



[Dimension] Unit: mm

Mark	L	W	T	a	b	c	d
Dimension	0.65±0.04	0.5±0.04	0.3±0.05	0.225±0.04	0.125±0.04	0.25±0.04	0.2±0.04

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

地址: 深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

4

b、PIN Configuration

①	②	③	④
Input/Output	Input/Output	GND	GND

c、Material

Part Name 名称	Structure and Material 结构及材料
Resonator 谐振体	Dielectric Material LTCC 介质材料
In/Output Terminals 输入/输出	Ag 银
Ground Base 接地面	Ag 银

4 测试条件 Testing Conditions

除非另有规定，否则在以下条件下测试 <Unless otherwise specified>

温度 Temperature : Ordinary Temperature (5 to 35℃)

湿度 Humidity : Ordinary Humidity (25 to 85% RH)

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

当对测量结果有疑问时<In case of doubt>

温度 Temperature : 20±2℃

湿度 Humidity : 60 to 75% RH

大气压强 Atmospheric Pressure : 86 to 106 kPa

5 电气性能 Electrical Characteristics

操作温度范围 Operating Temperature Range : -40 to +85℃

保存温度范围 Storage Temperature Range : -40 to +85℃

No.	Item (项目)	Specifications (特性)
5.1	Frequency Range 频率范围	824~915 MHz
5.2	Insertion Loss 插入损耗	≤0.5dB
5.3	Return Loss 回波损耗	≥14dB
5.4	Attenuation 阻带衰耗	≥20dB (2400~2750MHz)
5.5	In/Output Impedance 输入/输出阻抗	50 Ω
5.6	Power Capacity 功率容量	2.0 W Max.

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

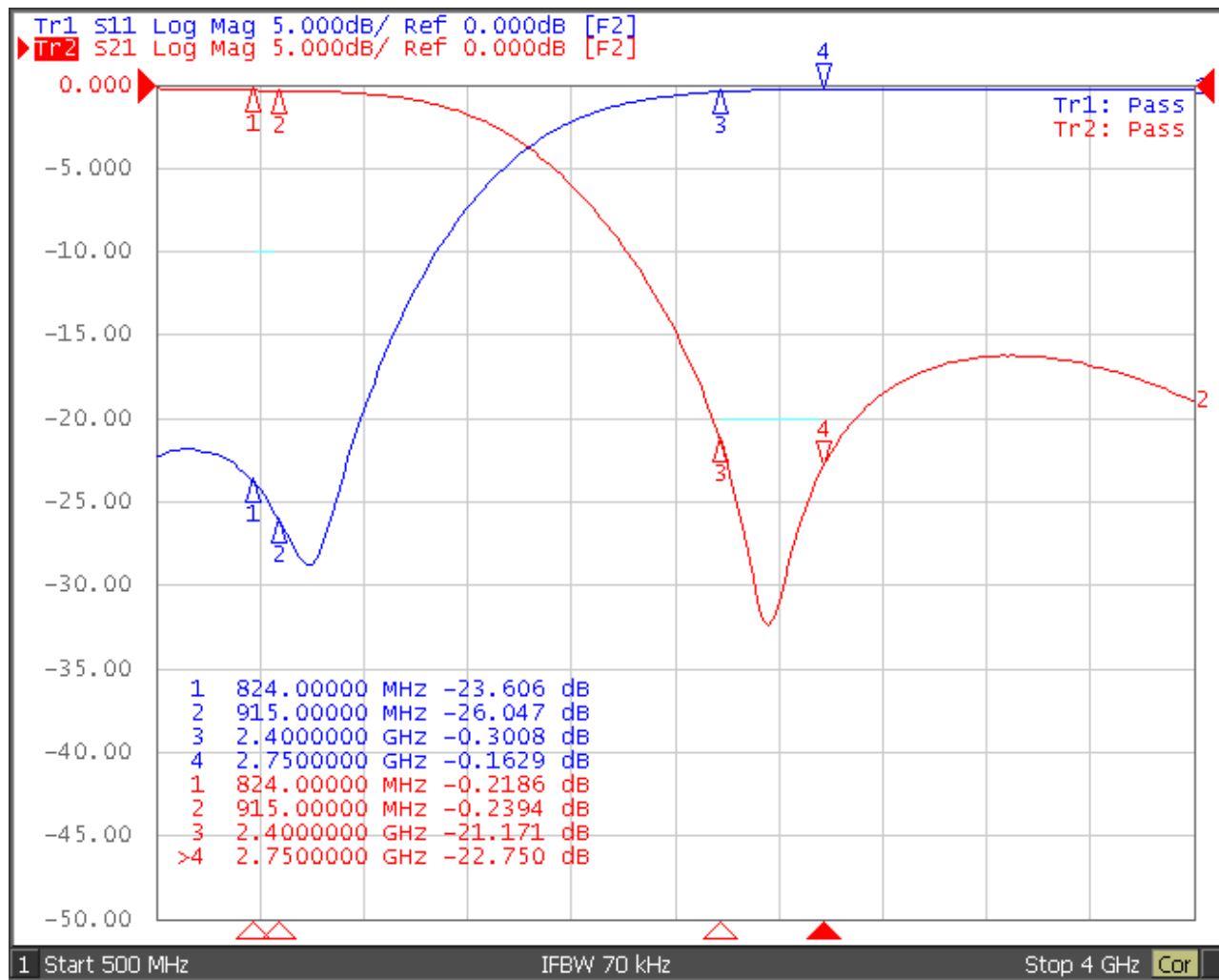
地址：深圳市坪山新区坪山大道 6075 号龙田科技园二巷 6 号

电话(Tel): 0755-28085000

传真(Fax): 0755-28085605

邮编(Postcode): 518110

6 特性曲线 Characteristic curve



7 焊接条件 Recommended Soldering Conditions

1、焊剂 Flux, Solder

① 使用松香助焊剂，禁止使用卤化物含量超过 0.2wt% 的强酸性助焊剂。

Use rosin-based flux. Don't use highly acidic flux with halide content exceeding 0.2wt% (chlorine conversion value).

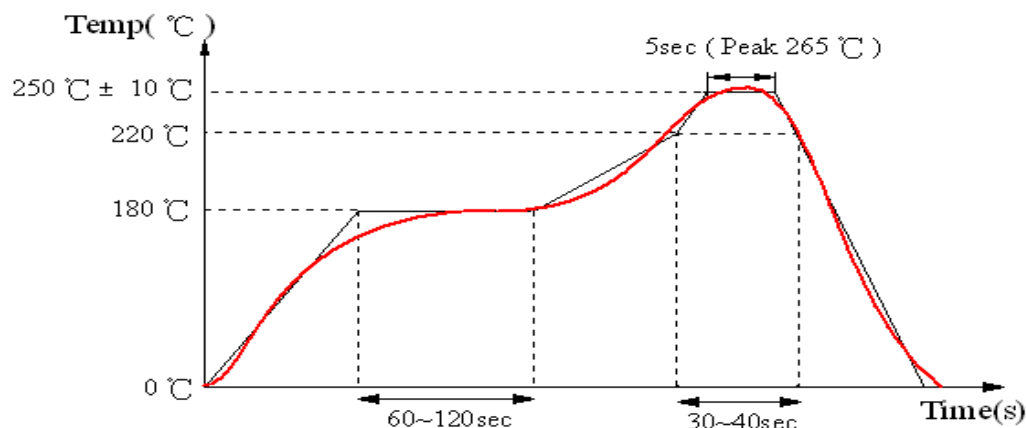
② 使用纯锡焊料 Use Sn solder.

2、回流焊条件 Reflow soldering conditions

● 预热时，产品表温与焊料温度的温差最大不允许超出 150℃，焊接完后冷却时，产品表温与溶剂温度之间的温差最大不允许超出 100℃。预热不足有可能引发产品表面裂纹，导致产品品质下降。

Pre-heating should be in such a way that the temperature difference between solder and product surface is limited to 150℃ max. Cooling into solvent after soldering also should be in such a way that temperature difference is limited to 100℃ max. Unwrought pre-heating may cause cracks on the product, resulting in the deterioration of products quality.

● 标准回流焊曲线 Standard soldering profile.



3、手工返工 Reworking with soldering iron

当使用电烙铁进行手工焊接时，以下条件必须严格遵守 The following conditions must be strictly followed when using a soldering iron.

预热 Pre-heating	150℃, 1 minute
尖端温度 Tip temperature	350℃ max
输出功率 Soldering iron output	80w max
电烙铁头尖端尺寸 End of soldering iron	φ3mm max
焊接时间 Soldering time	3 seconds max